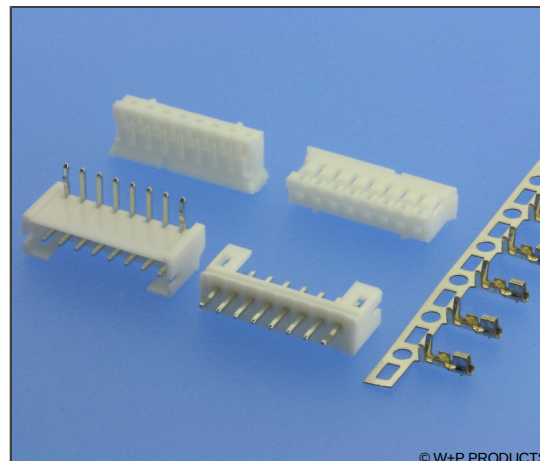


Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt

Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

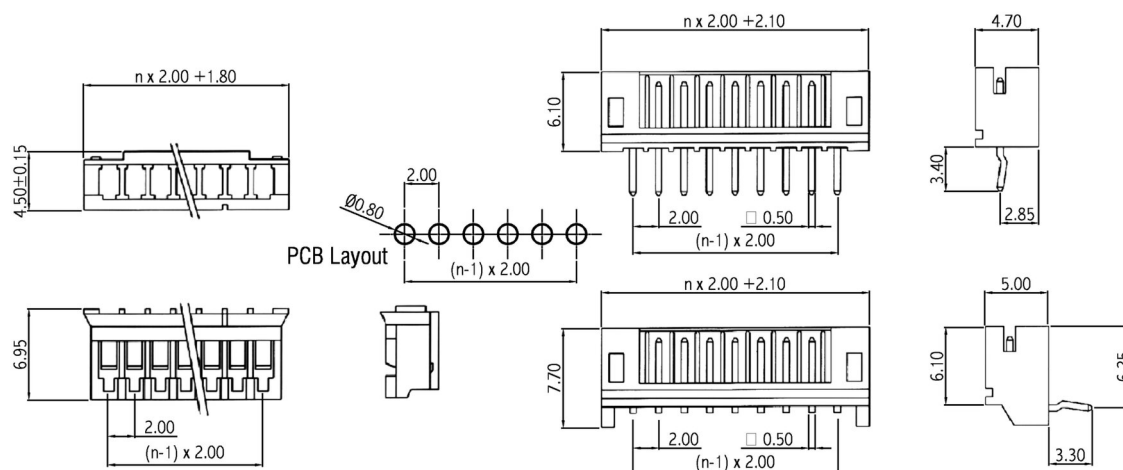
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.50mm, copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 30 ~ 24
Wire Gauge	AWG 30 ~ 24
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	800 V AC
Withstanding Voltage	800 V AC
Nennspannung	100 V AC
Voltage Rating	100 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



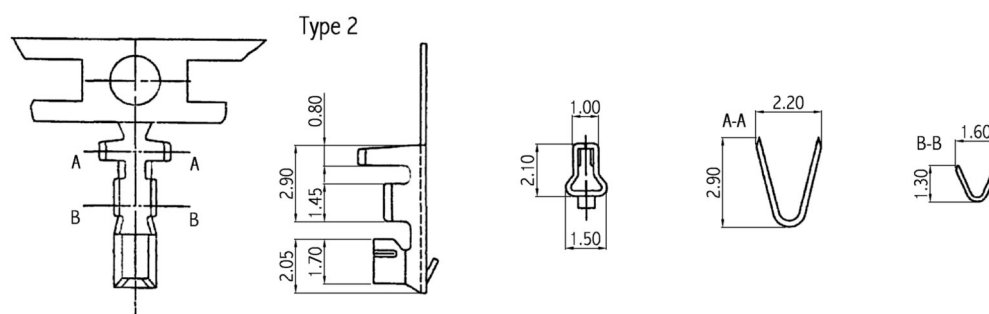
© W+P PRODUCTS

Buchsengehäuse passt auch zur Serie:
Housing mates also with Series:

5210



Series	Contacts*	Type*	Plating
521	12 02-16	3 1 Buchsengehäuse Housing 3 Stiftleiste gerade Straight pin header 4 Stiftleiste gewinkelt Right-angled pin header	50 50 Verzinnt (für Gehäuse nicht erforderlich) Tin plated (not used for housings) XX (ohne Plating für Gehäuse) (without plating, for housings)



Series	Contacts	Type	Plating
521	01	2 2 Buchsenkontakte AWG 24-30 Crimp Terminals AWG 24-30	50 50 Verzinnt Tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

